**第五届华进开放日报名表**

**5th NCAP OPEN DAY REGISTRATION FORM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称**  **Company** |  | | | | |
| **公司行业分类**  **Company Industry Classification** | 装备/Equipment□ 材料/Material□ 设计/Design□  终端/End user□ 封测/OSATs□ 代工/Foundries□  整合元件制造/IDM□ 资讯/Consulting□ 媒体/Media□  大学/University□ 其他/Other□ | | | | |
| **企业会员类型**  **Company Membership** | 🞐FOPLP联合体二期项目会员/ 2nd Phase FOPLP Consortium Member  🞐国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟会员/National Technology Innovation Strategic Alliance for IC Assembly and Testing Member  🞐江苏省半导体行业协会会员/Jiangsu Semiconductor Industry Association Member | | | | |
| **门票价格**  **Ticket Rate** | 1. **上述三类会员单位**：免费 2. **非上述三类单位**：500元/人 | | | | |
| **参会代表**  **Name** | **职务**  **Title** | **门票价格**  **Ticket Rate** | **邮箱**  **Email** | **参加晚宴**  **Dinner** | **手机号**  **Mobile** |
|  |  | 🞐Free 🞐500 |  | 🞐是 🞐否 |  |
|  |  | 🞐 Free 🞐500 |  | 🞐是 🞐否 |  |
|  |  | 🞐 Free 🞐500 |  | 🞐是 🞐否 |  |
|  |  | 🞐 Free 🞐500 |  | 🞐是 🞐否 |  |
|  |  | 🞐 Free 🞐500 |  | 🞐是 🞐否 |  |
| **会议联系人**  **Contact** |  | **邮箱**  **Email** |  | **手机号**  **Mobile** |  |
| **付款信息/Payment Information**  **（开票信息请另附/please provide your billing information in another file）** | | | | | |
| 公司名称：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司  公司地址：无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园D1栋  账 号：10635001040222409  银行名称：中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行  银行地址：无锡新发汇融商务广场2号 | | | | | |

**（注：本表填写后发电子邮件给我们，报名截止日期 11月4日；现场签到时，请出示名片，谢谢！）**